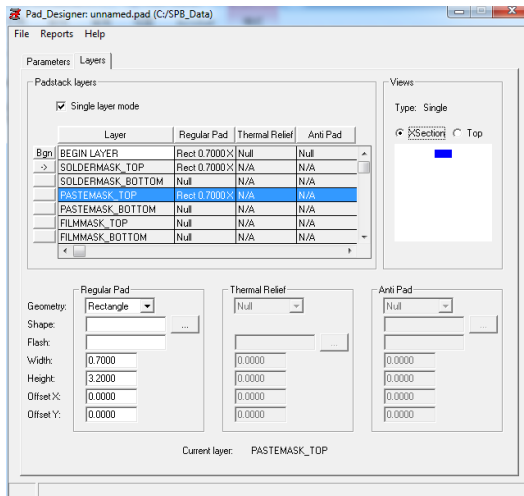




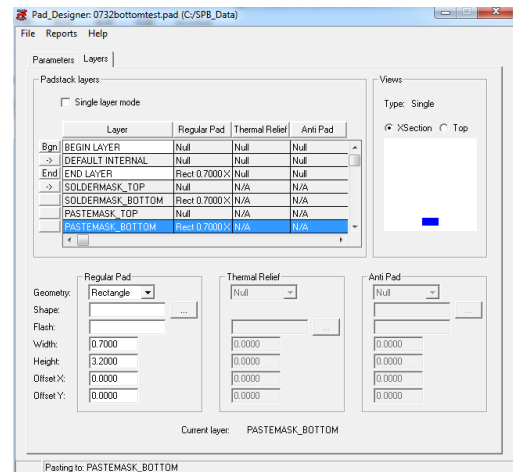
Allegro 制作双侧表贴封装

制作焊盘

因为我们要在 Top 层和 Bottom 层都放置焊盘, 所以在制作焊盘的时候就需要制作两种类型的焊盘, 一种对应 Top 层, 一种对应 Bottom 层. 首先来制作 top 层的焊盘, 打开 Pad designer, 设置参数如下图:

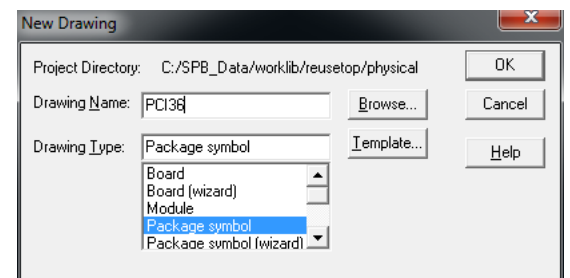


将上面的焊盘保存, 新建一个焊盘配置参数如下, 注意上下两图的不同.

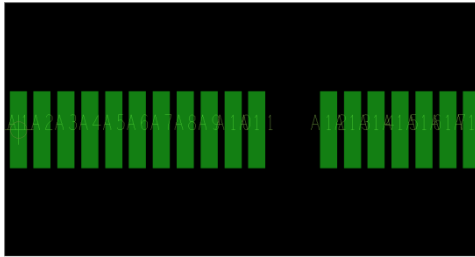


建立封装

焊盘建立完毕后我们需要建立封装, 打开 PCB Editor, 新建一个 Package Symbol



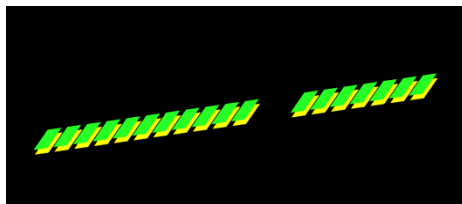
修改图纸尺寸及栅格点后开始放置焊盘, 先放置 top 层焊盘



然后放置 Bottom 层焊盘,



查看 3D 视图如下:



添加必须的丝印层、装配层、place bound 以及 RefDes 完成封装

Comtech 解决方案

- Cadence PCB 设计平台建设
- ECAD/CIS 库平台建设
- Allegro 软件二次开发
- PCB 项目设计及仿真外包服务
- Cadence 软件培训服务

Comtech 优势

- 实力雄厚的资深技术团队, 多名 10 年以上经验的 FAE
- 丰富的 PCB 设计/EDA 平台建设等实践经验
- 出色的二次开发能力, 为客户提供各种定制化开发需求
- 高效的技术服务平台, 通过电话/邮件/Web/BBS, 及时帮客户解决各类软件使用/设计相关问题
- 实战指导、项目现场支持等特色服务
- 最新技术资料下载客户专享通道, 包括软件使用技巧、设计经验、国外技术文献翻译等
- 为客户提供量身定制的全面的针对性培训服务

联系方式

深圳总部: 深圳市南山区高新科技园高新南九道 55 号微软科通大厦 11 楼

联系人: 陈敏敏

地址: 上海市桂林路 406 号华鑫中心 2 号楼 703-704 室

邮编: 200050

手机: 18017922811

电话: 021-51696680-8057

传真: 021-52370712